

安信证券股份有限公司

关于无锡市好达电子股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

二〇二一年六月

上海证券交易所：

安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“安信证券”、“本保荐机构”）接受无锡市好达电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“好达电子”、“公司”）的委托，就其首次公开发行股票并在科创板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。

安信证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《科创板注册办法》”）以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《无锡市好达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义。

目 录

| | |
|---|----|
| 目 录..... | 2 |
| 一、发行人基本情况 | 3 |
| 二、本次发行情况 | 16 |
| 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况 | 18 |
| 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况..... | 19 |
| 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 | 20 |
| 六、发行人就本次证券发行上市履行的相关决策程序 | 21 |
| 七、保荐机构关于发行人是否符合科创板定位的核查 | 22 |
| 八、保荐机构对发行人是否符合科创板上市条件的核查 | 22 |
| 九、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 | 26 |
| 十、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 | 28 |

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

| | |
|---------------|---|
| 公司名称 | 无锡市好达电子股份有限公司 |
| 英文名称 | Shoulder Electronics Co.,Ltd. |
| 注册资本 | 7,625.00 万元 |
| 法定代表人 | 刘平 |
| 成立日期 | 1999 年 6 月 14 日（股份有限公司成立于 2020 年 6 月 8 日） |
| 住所 | 无锡市滨湖经济技术开发区高运路 115 号 |
| 邮政编码 | 214124 |
| 电话号码 | 0510-85627586 |
| 传真号码 | 0510-85629160 |
| 互联网网址 | http://www.shoulder.cn/ |
| 电子信箱 | ir@wxsde.cn |
| 信息披露和投资关系的部门 | 董事会办公室 |
| 信息披露和投资者关系负责人 | 丁艳 |
| 信息披露负责人电话 | 0510-85629111 |

（二）主营业务情况

公司主要从事声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售，是兼具芯片设计技术、制造及封测工艺、标准化量产出货能力的国内厂商。公司主要产品包括滤波器、双工器和谐振器，广泛应用于手机、通信基站、物联网等射频通讯相关领域。

（三）发行人核心技术以及研发水平

1、发行人的核心技术

公司主要从事声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售，已具备成熟的芯片设计技术、制造与封测工艺，并拥有多项核心技术。公司现阶段所掌握的主要核心技术如下：

| 序号 | 核心技术类别 | 技术名称 | 技术来源 | 技术简介 | 保护措施 |
|----|--------|-----------------------|------|--|-------------------------|
| 1 | 芯片设计类 | 声表面波射频芯片精确仿真技术 | 自主研发 | 公司能够根据不同的理论基础自主开发出适用于不同种类的声表面波射频芯片仿真平台，并通过仿真平台对芯片的性能表现进行有效模拟。该核心技术在运用基础理论、开发软件工具等方面具有一定的技术成熟度，目前主要应用于声表面波射频芯片设计、产品质量分析、新技术开发和新材料研究等领域。 | 技术秘密、授权专利 6 项、软件著作权 1 项 |
| 2 | 芯片制造类 | 声表面波射频芯片前道技术 | 自主研发 | 公司的芯片制造能力能够满足芯片设计的参数要求，公司在匀胶、光刻、显影、蒸发、剥离、修频等芯片制造的关键工序上已积累形成具备竞争力的工艺能力。该核心技术在叉指换能器的线条加工、线条尺寸控制、金属膜厚控制等方面具有一定的技术成熟度，目前主要应用于高品质声表面波射频芯片的量产制造中。 | 技术秘密、授权专利 2 项 |
| 3 | | 高功率滤波器制造技术 | 自主研发 | 公司的芯片制造能力能够满足拓扑结构的设计要求，公司已能够制备性能稳定的高功率耐受性叉指换能器电极薄膜。该核心技术在提高滤波器的功率耐受性等方面具有一定的技术成熟度，目前主要应用于高功率滤波器的量产制造中。 | 技术秘密、授权专利 2 项 |
| 4 | 封装测试类 | 声表面波射频芯片 CSP、WLP 封装技术 | 自主研发 | 公司 CSP 封装能够生产尺寸为 0.9mm×0.7mm 的滤波器、1.6mm×1.2mm 的双工器，WLP 封装能够生产尺寸为 0.8mm×0.6mm 的滤波器、1.5mm×1.1mm 的双工器。该核心技术在减小封装面积与厚度、增加抗压性能等方面具有一定的技术成熟度，目前主要应用于高品质声表面波射频芯片的封装过程中。 | 技术秘密、授权专利 4 项 |

2、核心技术先进性及具体表征

(1) 芯片设计类核心技术

在芯片设计方面，公司具备 1 项核心技术，即声表面波射频芯片精确仿真技术。

1) 核心技术概述

芯片仿真即在开发平台上对芯片的性能表现进行模拟，用以确保芯片进入流片生产环节前符合预期设计要求，是芯片设计的关键环节。声表面波滤波器的工作原理涉及力学与电学的耦合，精确仿真技术难度较大，且市场上尚无成熟的商用软件可用。目前国际领先的声表面波滤波器厂商的仿真与设计平台均为自主研发，芯片仿真技术已成为声表面波滤波器厂商的核心竞争力之一。

芯片仿真的精确性取决于理论建模的有效性。不同种类的声表面波滤波器在声学、电学和材料特性存在差异，需要借由不同的理论模型进行仿真拟合。基础理论研究是声表面波滤波器设计与开发的前提，声表面波滤波器厂商的理论研究能力、模型构建能力能够对其芯片仿真技术水平产生深刻影响。针对声表面波滤波器的行业特点，公司专门在研发中心设置理论组进行基础理论与仿真软件开发。目前公司已根据不同的理论基础自主开发出适用于不同种类的声表面波滤波器的仿真软件，具体情况如下：

| 序号 | 开发时间 | 理论基础 | 仿真软件 | 产品类型 |
|----|------|----------------|---------------|------------------|
| 1 | 2007 | 脉冲响应模型与衍射补偿理论 | SAW designer | 传统切指加权滤波器 |
| 2 | 2009 | 声表面波耦合模理论 | COM simulator | Spudt 滤波器 |
| 3 | 2010 | 周期 FEM/BEM 理论 | Periodic SAW | 参数提取、基础研究、温度特性分析 |
| 4 | 2010 | 有限长 FEM/BEM 理论 | Finite SAW | 常规 SAW 滤波器 |
| 5 | 2012 | 电磁场理论与声波理论 | SAW platform | 低损耗滤波器 |
| 6 | 2018 | 有限元级联理论 | FEM SAW | TC-SAW 滤波器 |

2) 核心技术的先进性

公司运用滤波器基础理论所开发的上述仿真软件是公司射频芯片设计、产品质量分析、新技术开发和新材料研究得以实现的工具基础。作为核心技术之一，公司射频芯片精确仿真技术的先进性主要体现在公司基础理论的运用能力与软件工具的性能表现上的比较优势。

公司于 2010 年成功开发基于周期 FEM/BEM 理论的软件 Periodic SAW 和

基于有限长 FEM/BEM 理论的软件 Finite SAW，均可以应用于普通手机滤波器的仿真设计。FEM/BEM 模型中，半无限大真空介质、压电层用边界元方法建模，金属电极与介质层用有限元仿真，共同构建一套完整的数学模型，仿真结果更为准确。周期 FEM/BEM 理论可以用来分析材料特性（如提取反射系数、机电耦合系数、温度系数等基本技术参数），有限长 FEM/BEM 理论可以直接用来计算滤波器电性能参数，两种理论均是学界公认的分析普通声表面波滤波器的精确模型，亦已成为国外领先厂商和公司分析与设计声表面波滤波器的理论基础。

公司于 2018 年成功开发基于有限元级联理论的 FEM 软件，并应用于高性能手机滤波器的仿真设计。相较于普通滤波器，温度补偿型声表面波滤波器（TC-SAW）、多层介质声表面波滤波器等射频芯片性能表现更好，但结构较为复杂。公司根据有限元级联理论自主开发的 FEM 软件适用于复杂结构声学滤波器的精确分析，可以应用于 SAW、TC-SAW、IHP-SAW 等声表面波滤波器和 BAW、FBAR 等体声波滤波器的快速精确仿真，既能够用于现有产品的设计开发，也为公司新产品线的研发提供工具支持。此外，有限元级联理论是对声表面波滤波器进行仿真的先进理论，可以大幅提升仿真速度。以一个 300 根指的耦合双模谐振器型(DMS)滤波器为例，基于有限长 FEM/BEM 理论的软件 Finite SAW 仿真一个频率点需用时 5-10 秒，而基于有限元级联理论的 FEM SAW 软件用时仅 0.3-2 秒。

（2）芯片制造类核心技术

在芯片制造方面，公司具备 2 项核心技术，即声表面波射频芯片前道技术和高功率滤波器制造技术。

1) 声表面波滤波器前道技术

①核心技术概述

声表面波射频芯片的生产可以分为前道芯片制造和后道封装测试两大工序，其中前道芯片制造的关键工艺包括匀胶、光刻、显影、蒸发、剥离、修频等，其工艺水平能够决定声表面波射频芯片在电性能、一致性等主要指标上的

表现。只有较高的前道技术水平才能够满足声表面波滤波器在电极膜厚、介质膜厚、指条线宽、指条形状等相关参数方面的精确度要求，从而生产出在频率、损耗和驻波等方面表现良好的声表面波滤波器。前道工艺能力能够决定产品的性能表现和良品率，是声表面波滤波器厂商的核心竞争力之一。

公司在前道技术能力建设方面持续投入，芯片制造能力持续提升，已形成覆盖各关键工艺的声表面波射频芯片前道技术。

②核心技术的先进性

公司拥有 20 多年的射频芯片生产经验，在前道技术方面持续投入先进设备、开发技术工具并引入新式材料，不断创新关键工艺技术，已形成能够满足高品质滤波器制造要求的声表面波射频芯片前道技术。

滤波器在插入损耗方面的表现能够在一定程度上反映前道工艺技术水平。在手机通讯的部分常用频段中，公司量产的声表面波滤波器在插入损耗方面的表现较好。以 4G 通讯国内外常用频段 Band 40 的接收端用滤波器（Rx Filter）和 4G、5G 通讯国内外常用频段 Band 41 的发射端用滤波器（Tx Filter）为例，公司与国外领先厂商在插入损耗方面的对比情况具体如下：

单位：dB

| 序号 | 国外领先厂商 | 产品型号 | 插入损耗 (max) |
|--------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| Band 40 滤波器 (Rx Filter) | | | |
| 1 | 村田 | SAFFW2G35AA0E0A | 2.3 |
| 2 | 高通 (RF360) | B4352 | 4.0 |
| 3 | 太阳诱电 | F6QA2G350M2QA | 3.0 |
| 4 | 好达电子 | HDFB40DRSS-B29 | <u>2.2</u> |
| Band 41 滤波器 (Tx Filter) | | | |
| 1 | 村田 | SAFRC2G59MD0F0A | 3.7 |
| 2 | 高通 (RF360) | B9680 | 3.6 |
| 3 | 太阳诱电 | F6HQ2G593AP31 | 3.6 |
| 4 | 好达电子 | HDFB41YPSS-B5 | <u>3.2</u> |

注：1、国外领先厂商的产品性能数据均来自于官网披露（截至 2021 年 6 月 23 日）的规格书；
 2、除高通 (RF360)、太阳诱电 Band 41 的发射端用滤波器 (Tx Filter) 为体声波滤波器外，其余表中各型号滤波器均为声表面波滤波器；
 3、高通 (RF360) 官网未披露手机用滤波器规格书，表中系汽车电子/小基站用滤波器；
 4、插入损耗 (IL) 是衡量滤波器信号通过性能的指标，数值越低表示对频段内需保留信号的衰减越小；

5、下划线并加粗表示该项指标表现最优者。

由上表可以看出，在国内外移动通讯的常用频段 Band 40 和 Band 41 所用滤波器中，公司产品相比于同行业公司插入损耗（IL）的数值较低，已达到国外领先厂商的技术水平，能在一定程度上反映出公司声表面波射频芯片前道技术的先进性。

2) 高功率滤波器制造技术

①核心技术概述

随着移动通信系统输入功率的提高和器件尺寸的减小，声表面波滤波器承受的功率密度越来越大。传统多晶铝换能器电极材料在高功率信号加载下，容易引起铝原子迁移和器件发热，从而导致器件短路或断路，严重影响器件的可靠性。

公司经过持续研发，现已掌握换能器电极材料与压电材料间的机电耦合规律，能够厘清力、电、热协同作用下声表面波滤波器失效机理，业已形成一套切实可行的、性能稳定的高功率耐受性叉指换能器电极薄膜制备加工和滤波器拓扑结构增强功率优化设计技术。

②核心技术的先进性

公司通过采用纳米过渡层调控薄膜材料的结构和晶体取向，能够提升多晶铝电极抗电迁移能力、增加芯片功率耐受性。公司滤波器产品采用具有强织构的抗电迁移材料，对比传统多晶铝换能器电极材料，结合力提高约 2 倍，抗电迁移能力提升约 10 倍，成功解决了滤波器因原子迁移导致器件损坏的难题，大幅度提高了滤波器的功率耐受性；另外，通过优化声表面波滤波器的拓扑结构，有效降低声表面波芯片上的能量密度，从而进一步提高芯片的功率耐受性。通过换能器材料和拓扑结构设计两者的结合，公司已将传统的声表面波滤波器的耐受功率从 29dBm 提升到 35dBm，提升了 3.75 倍，能够满足移动通信对高功率声表面波滤波器的需求。

公司高功率滤波器制造技术已具备较高的先进性与成熟度。在技术方面，公司参与的“高世代声表面波材料与滤波器产业化技术”项目于 2018 年获得国

家科学技术进步奖二等奖，其中高功率滤波器制造技术是获奖内容之一；在产品方面，公司自主研发的高功率声表面波滤波器产品已向小米、华勤、龙旗、广和通等下游知名客户实现销售，产品成熟度较高。

3) 封装测试类核心技术

在封装测试方面，公司具备 1 项核心技术，即声表面波射频芯片 CSP、WLP 封装技术。

①核心技术概述

目前手机射频前端中滤波器存在分立和模组两种集成模式。

分立模式下，手机滤波器主要采取 CSP（Chip Scale Package）的封装形式，即芯片级封装。CSP 封装是声表面波滤波器分立器件最小封装形式。在 CSP 封装之前，手机用声表面波滤波器的最小的封装形式是 SMD 封装，最小尺寸 3mm×3mm，双工器最小尺寸 5mm×5mm。在 2G 时代，手机支持的频段少，所用滤波器、双工器数量不多，随着 3G、4G 手机的普及，手机支持多个频段，滤波器、双工器的数量大幅增加，SMD 封装不能满足手机对滤波器小型化的需求，更小尺寸的 CSP 封装形式逐渐成为主流。CSP 封装的关键技术包括基板设计、植球、倒装、覆膜、测试等。国内手机用声表面波滤波器的 CSP 封装技术起步较晚，公司于 2012 年攻克 CSP 关键工艺，成功开发并量产手机用 CSP 封装声表面波滤波器与双工器。此后，公司不断改善与提升 CSP 技术，生产良率与可靠性不断提升，目前公司芯片级封装（CSP）生产线能够生产产品尺寸为 0.9mm×0.7mm 的滤波器、1.6mm×1.2mm 的双工器。

模组模式下，手机滤波器主要采取 WLP（Wafer Level Package）封装形式，即晶圆级封装。随着 5G 的到来，手机内部空间愈发紧张，模组化集成能够进一步减少射频芯片的占用空间，是未来射频前端的发展趋势。目前手机射频前端的模组方案主要包括 DiFEM（集成射频开关、滤波器）、LDiFEM（集成射频开关、滤波器和低噪声放大器）、FEMid（集成射频开关、天线、双工器）和 PAMid（集成 FEMiD、MMMD PA）等，已使用在高端智能手机中，并不断向物联网、车联网等应用领域发展。集成在模组中的滤波器尺寸更小、更薄，同

时因为模组需要注塑工艺进行封装，滤波器需要耐受 180℃ 的高温与 3-5MPa 的压力，这均对滤波器的封装形式提出新的要求。晶圆级封装（WLP）是目前声表面波滤波器尺寸最小的一种封装形式，亦能满足模组注塑工艺中的高温抗压要求。目前公司晶圆级封装（WLP）生产线能够生产产品尺寸为 0.8mm×0.6mm 的滤波器、1.5mm×1.1mm 的双工器。

②核心技术的先进性

公司于 2012 年成功开发芯片级封装（CSP）技术，目前已成功量产百余款以 CSP 为封装形式的声表面波滤波器；公司近年来亦在覆膜、光刻、植球、电镀等 WLP 关键工艺上实现突破，于 2019 年成功开发晶圆级（WLP）封装技术，目前已成功量产数十款以 WLP 为封装形式的声表面波滤波器。公司声表面波滤波器 CSP、WLP 封装技术成熟，相关产品均已应用于下游知名客户的智能手机中，在芯片尺寸、综合性能等方面与国外领先厂商大致相当。以 4G 通讯国内外常用频段 Band 40 的接收端用滤波器（Rx Filter）和 4G、5G 通讯国内外常用频段 Band 41 的发射端用滤波器（Tx Filter）为例，公司与国外领先厂商在芯片尺寸方面的对比情况具体如下：

单位：mm

| 序号 | 国外领先厂商 | 产品型号 | 芯片尺寸 |
|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Band 40 滤波器（Rx Filter） | | | |
| 1 | 村田 | SAFFW2G35AA0E0A | <u>0.9×0.7</u> |
| 2 | 高通（RF360） | B4352 | 1.4×1.1 |
| 3 | 太阳诱电 | F6QA2G350M2QA | 1.1×0.9 |
| 4 | 好达电子 | HDFB40DRSS-B29 | <u>0.9×0.7</u> |
| Band 41 滤波器（Tx Filter） | | | |
| 1 | 村田 | SAFRC2G59MD0F0A | 1.4×1.1 |
| 2 | 高通（RF360） | B9680 | 1.8×1.4 |
| 3 | 太阳诱电 | F6HQ2G593AP31 | 1.8×1.4 |
| 4 | 好达电子 | HDFB41YPSS-B5 | <u>1.1×0.9</u> |

注：1、国外领先厂商的芯片尺寸数据均来自于官网披露（截至 2021 年 6 月 23 日）的规格书；

2、除高通（RF360）、太阳诱电 Band 41 的发射端用滤波器（Tx Filter）为体声波滤波器外，其余表中各型号滤波器均为声表面波滤波器；

3、高通（RF360）官网未披露手机用滤波器规格书，表中系汽车电子/小基站用滤波器；

4、滤波器尺寸越小制造工艺难度越大，封装技术水平越高；

5、下划线并加粗表示该项指标表现最优者。

由上表可以看出，在国内外移动通讯的常用频段 Band 40 和 Band 41 所用滤波器中，公司的芯片尺寸已达到国外领先厂商的产品标准，能在一定程度上反映出公司声表面波滤波器封装技术的先进性。

（四）主要经营和财务数据及指标

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度、2019 年度和 2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了无保留意见的《审计报告》（苏公 W[2021]A996 号），发行人报告期内主要财务数据及财务指标如下：

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 资产总额（万元） | 92,645.83 | 43,539.62 | 24,419.09 |
| 归属于母公司股东权益（万元） | 55,122.61 | 24,734.28 | 16,946.13 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 40.10 | 42.38 | 30.12 |
| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 营业收入（万元） | 33,243.77 | 20,642.44 | 16,528.83 |
| 净利润（万元） | 4,657.39 | 2,886.52 | 2,880.42 |
| 归属于母公司所有者的净利润（万元） | 4,680.35 | 2,886.52 | 2,880.42 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） | 4,402.88 | 2,549.36 | 2,681.45 |
| 基本每股收益（元） | 0.60 | - | - |
| 稀释每股收益（元） | 0.60 | - | - |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.14 | 13.83 | 22.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 5,335.70 | 4,825.75 | 2,955.68 |
| 现金分红（万元） | 1,417.18 | - | 1,150.99 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 12.42 | 9.69 | 7.86 |

（五）发行人存在的主要风险

1、技术风险

（1）技术研发风险

声表面波射频芯片主要应用于手机、通信基站、物联网等射频通讯相关领域，其技术创新与通信技术的发展紧密相关。由于通信行业发展迅速，技术升级和更新迭代速度较快，若公司不能持续保持充足的研发投入，或公司技术研发方向与市场发展趋势偏离，使得新产品技术指标无法满足客户需求，将导致公司与国外领先厂商的差距扩大甚至被国内同行业竞争对手赶超，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

（2）核心技术泄密风险

公司通过长期研发积累所形成的核心技术是生产公司各类主要产品的技术基础。公司核心技术涉及芯片设计、制造和封装测试各个环节，对公司经营和长期发展有着重大影响。公司不能完全排除在生产经营过程中相关技术或保密信息泄露、相关技术人员不慎泄密或竞争对手采用非法手段获取本公司的核心技术等风险，进而可能导致公司核心技术泄密。若相关核心技术泄密并被竞争对手获知和模仿，将可能给公司市场竞争力带来不利影响。

（3）技术人才流失风险

公司所处行业具有技术密集型和人才密集型特征，技术人才是公司的核心竞争力之一。技术人员对于新产品设计研发、产品质量控制以及提供稳定优质的技术服务具有至关重要的作用。在市场竞争日益激烈的情况下，公司面对的人才竞争也将日趋激烈，技术团队的稳定性将面临考验，公司可能存在技术人才流失的风险。未来若发生技术人才大量流失或因规模扩张导致人才不足的情形，将可能影响公司发展战略的顺利实施，并对公司的生产经营产生不利影响。

2、经营风险

（1）市场竞争风险

射频前端芯片产业具有技术密集型特征，设计技术与制造工艺的难度较高。根据 Yole 数据，2018 年声表面波滤波器行业 95% 以上的市场份额被村田、高通（RF360）、太阳诱电、思佳讯和威讯等国外领先厂商占有，行业已形成一定的技术经验壁垒和市场进入壁垒。公司与该等国外领先厂商相比，在业务规模、技术实力、客户资源、人才储备等方面仍存在一定差距。此外，随着国家对射

频前端芯片产业重视程度的提升，国产替代进程加速，国内厂商纷纷加大资本投入进行市场拓展，公司将面临更为激烈的市场竞争格局。

若公司未能正确把握市场动态和行业发展趋势，或未能根据客户需求及时进行技术和产品创新，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等可能受到不利影响。

（2）国际贸易摩擦风险

近年来，伴随着全球产业格局的深度调整，逆全球化思潮出现，国际贸易摩擦不断。在销售端，报告期各期，公司外销收入均在 5,000 万元以上，且公司国内客户如小米等，其产品亦部分出口至国外；在采购端，公司生产设备如光刻机、测试机等部分向国外供应商采购。若未来与中国相关的国际贸易摩擦持续发生，公司的持续经营能力将面临潜在不利影响。

（3）客户集中度提高风险

报告期各期，公司对前五大客户销售金额分别为 7,378.89 万元、11,149.30 万元和 19,355.28 万元，占公司营业收入的比例分别为 44.64%、54.01% 和 58.22%，客户集中度逐年上升。若未来公司技术水平、产品质量未能达到主要客户的要求或主要客户的经营情况、资信情况等发生重大不利变化，公司将无法继续维持与主要客户的合作关系，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

（4）新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营影响

2020 年初以来，国内外爆发了新型冠状病毒肺炎疫情。目前我国已在很大程度上抑制了疫情的蔓延，但海外地区的疫情形势仍然较为严峻，且存在进一步大范围扩散的可能。若全球疫情长期持续或继续恶化，可能在一定程度上影响下游客户的销售计划、上游供应商的供货即时性，进而对公司的生产经营和经营业绩产生不利影响。

3、内控风险

（1）实际控制人持股比例较低的风险

公司实际控制人刘平通过持有好达投资、共进同达的出资额及担任共进同

达的执行事务合伙人持有公司 20.84%的股权，拥有公司 32.50%的表决权。本次公开发行完成后，公司实际控制人持股及表决权比例将进一步降低，将间接持有公司 15.63%的股权，拥有公司 24.37%的表决权。公司存在本次公开发行完成后实际控制人拥有表决权比例较低，从而产生决策效率降低的风险，可能对公司的业务开展产生不利影响。

（2）管理风险

公司在发展过程中业已建立符合公司自身业务特点的经营模式及较为完善的法人治理结构，具有丰富经验的管理团队及较为完整的管理制度。随着公司生产规模持续扩大，研发、采购、生产及销售等环节的资源配置和内控管理的复杂程度不断提升，对公司组织架构和管理能力的要求也相应显著提高。若未来公司管理机制无法适应业务规模增长需求，公司的发展将面临一定的管理风险。

4、财务风险

（1）存货跌价的风险

报告期各期末，公司存货分别为 3,371.96 万元、3,295.39 万元和 6,036.57 万元，占流动资产的比重分别为 27.34%、17.99%和 21.15%。随着生产经营规模的扩大，公司存货呈现上升的趋势。若公司因未能及时把握下游行业变化、未能及时优化存货管理或其他难以预计的原因导致存货无法顺利实现销售，可能导致存货可变现净值低于成本，使公司存在增加计提存货跌价准备的风险，从而对公司盈利能力造成不利影响。

（2）应收账款的回收风险

报告期各期末，公司应收账款分别为 4,109.83 万元、5,591.33 万元和 10,478.39 万元，占流动资产的比重分别为 33.32%、30.52%和 36.71%。由于公司业务规模的快速增长，应收账款呈持续增长趋势。未来若客户的财务状况、合作关系发生恶化或催收措施不力，则公司将面临一定的应收账款回收风险，对公司盈利能力造成不利影响，亦会影响公司经营性现金流量，对公司资金状况造成不利影响。

（3）关联交易风险

公司关联销售的主要内容为向知名手机终端品牌小米、华为，以及知名手机 ODM 代工厂商华勤销售用于手机射频前端的滤波器、双工器产品。报告期各期，公司向关联方销售商品金额分别为 161.37 万元、4,719.40 万元和 9,888.66 万元，占营业收入的比重分别为 0.98%、22.86%和 29.75%，关联销售金额及占销售收入的比重逐年上升。

根据公司和关联客户的经营需求，公司预计与小米、华勤、华为等关联方的交易将持续存在，并具有交易金额上升的可能性。若公司未能严格执行其内控制度或未能履行关联交易决策、审批程序，则存在关联方利用关联交易或往来损害公司或其他股东利益的风险。

（4）企业所得税税收优惠风险

公司于 2017 年取得《高新技术企业证书》（证书编号分别为：GR201732001846），并于 2020 年 12 月通过高新技术企业复审，取得《高新技术企业证书》（证书编号分别为：GR202032003640）。根据相关政策规定，报告期内公司可享受 15%的所得税优惠税率。未来若国家所得税相关政策发生重大不利变化或公司的高新技术企业资格在有效期满后未能顺利通过重新认定，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

5、诉讼风险

截至本上市保荐书签署日，公司存在未决诉讼。村田于 2021 年 1 月向福州市中级人民法院递交两份《起诉状》，认为公司制造、销售和许诺销售共三种型号的滤波器对其造成侵权行为，请求法院判令公司停止侵权行为并合计赔偿 60 万元，并保留根据后续在诉讼中获得的证据以及好达电子侵权延续造成的损失而向好达电子主张侵权赔偿金的权利。

目前，上述案件已立案，尚未开庭，公司已提起管辖权异议程序，同时公司对村田的涉案专利提出无效宣告的请求。若未来公司在上述诉讼中败诉，将对公司的声誉、经营业绩和财务状况产生一定的不利影响。

6、募投项目无法如期取得环评批复的风险

公司本次募投项目中的声表面波滤波器扩产建设项目和研发中心建设项目需取得无锡市行政审批局的环评批复。截至本上市保荐书签署日，公司已向江苏无锡经济开发区行政审批局提交环评相关材料。若公司无法按时取得主管部门的环评批复，上述募投项目将面临施工进度延后、项目收益无法达到预期的风险。

7、发行失败风险

公司本次申请首次公开发行股票并在科创板上市，其发行结果将受到公开发行时国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来趋势判断等诸多内外部因素的影响，可能存在因认购不足而导致的发行失败风险。同时，在中国证监会同意注册决定的有效期内，按照市场化询价结果确定的发行价格，可能存在因公司预计发行后总市值不满足在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准，而导致发行失败的风险。

8、摊薄即期回报风险

本次发行完成后，随着募集资金的到位，发行人的股本总数、净资产规模将在短时间内大幅增长，而募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目全部购建完成后才能逐步达到预期收益水平。因此，发行人短期内存在净资产收益率和每股收益被摊薄的风险。

二、本次发行情况

本次发行前，发行人总股本为 7,625 万股，本次公开发行新股不超过 2,541.67 万股，占发行后总股本的比例为 25%。本次发行完成后，发行人的总股本不超过 10,166.67 万股。

| (一) 本次发行的基本情况 | | | |
|---------------|-------------------------------------|-----------|---------|
| 股票种类 | 人民币普通股（A 股） | | |
| 每股面值 | 1.00 元 | | |
| 发行股数 | 不超过 2,541.67 万股（不含采用超额配售选择权发行的股份数量） | 占发行后总股本比例 | 不低于 25% |

| | | | |
|-------------|--|-----------|---|
| 其中：发行新股数量 | 不超过 2,541.67 万股(不含采用超额配售选择权发行的股份数量) | 占发行后总股本比例 | 不低于 25% |
| 股东公开发售股份数量 | 无 | 占发行后总股本比例 | 无 |
| 发行后总股本 | 不超过 10,166.67 万股（不含采用超额配售选择权发行的股份数量） | | |
| 每股发行价格 | 【】元/股 | | |
| 发行市盈率 | 【】倍 | | |
| 发行前每股净资产 | 【】元/股（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算） | 发行前每股收益 | 【】元/股（按发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 【】元/股（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） | 发行后每股收益 | 【】元/股（按发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算） |
| 发行市净率 | 【】倍（按每股发行价格除以发行前每股净资产） | | |
| | 【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产） | | |
| 发行方式 | 网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式；本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15% | | |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人、战略投资者等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则禁止购买者除外 | | |
| 承销方式 | 余额包销 | | |
| 拟公开发售股份股东名称 | 无 | | |
| 发行费用的分摊原则 | 发行人本次申请首次公开发行股票并在科创板上市涉及的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用均由发行人承担 | | |
| 募集资金总额 | 【】亿元 | | |
| 募集资金净额 | 【】亿元 | | |
| 募集资金投资项目 | 声表面波滤波器生产建设项目 | | |
| | 研发中心建设项目 | | |
| | 补充流动资金 | | |
| 发行费用概算 | 承销、保荐费用 | 【】万元 | |

| | | |
|------------------------|----------------|------|
| | 审计、验资及评估费用 | 【】万元 |
| | 律师费用 | 【】万元 |
| | 信息披露费、发行手续费及其他 | 【】万元 |
| | 总计 | 【】万元 |
| (二) 本次发行上市的重要日期 | | |
| 刊登发行公告日期 | 【】年【】月【】日 | |
| 开始询价推介日期 | 【】年【】月【】日 | |
| 刊登定价公告日期 | 【】年【】月【】日 | |
| 申购日期和缴款日期 | 【】年【】月【】日 | |
| 股票上市日期 | 【】年【】月【】日 | |

三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况

(一) 本次具体负责推荐的保荐代表人

安信证券作为好达电子首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，授权周鹏翔先生、王庆坡先生担任保荐代表人，具体负责发行人本次证券发行上市的尽职推荐及持续督导等保荐工作。两位保荐代表人的保荐业务执业情况如下：

1、周鹏翔先生的保荐业务执业情况

周鹏翔先生：安信证券投资银行业务委员会业务总监，保荐代表人。曾主持或参与东威科技(688700.SH)、尤安设计(300983.SZ)、金陵体育(300651.SZ)、隆盛科技(300680.SZ)、苏利股份(603585.SH)、启迪设计(300500.SZ)、普丽盛(300442.SZ)、扬杰科技(300373.SZ)、日出东方(603366.SH)、林洋能源(601222.SH)、百川股份(002455.SZ)、延安必康(002411.SZ)、科远智慧(002380.SZ)等多家企业的改制辅导与发行上市工作，以及科远智慧(002380.SZ)非公开发行工作，具有扎实的资本运作理论功底与丰富的投资银行业务经验。

周鹏翔先生自执业以来，未受到监管部门的任何形式的处罚。

2、王庆坡先生的保荐业务执业情况

王庆坡先生：安信证券投资银行业务委员会高级副总裁，保荐代表人。曾主持或参与东威科技（688700.SH）、尤安设计（300983.SZ）、华脉科技（603042.SH）等多家企业的改制辅导与发行上市工作，具有扎实的理论功底及丰富的投资银行业务经验。

王庆坡先生自执业以来，未受到监管部门的任何形式的处罚。

（二）项目协办人及其他项目组成员

本次发行的项目协办人为陈磊先生，其他项目组成员包括：丁骥先生、汤正先生、万伟伦先生、吴日源先生。

项目协办人：陈磊先生，安信证券投资银行业务委员会高级经理。曾参与东威科技（688700.SH）、罗博特科（300757.SZ）等企业的改制辅导与首次公开发行上市以及安井食品（603345.SH）再融资等工作，具有较丰富的投资银行业务知识和项目经验。

四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况

（一）本保荐机构和发行人之间的权益关系情况：

1、国投创业持有发行人 0.70% 的股份；

2、国家开发投资集团有限公司之子公司中国国投高新产业投资有限公司持有发行人股东国投创业 20.00% 的股份；中国国投高新产业投资有限公司之子公司国投创业投资管理有限公司持有发行人股东国投创业 2.00% 的股份并担任其执行事务合伙人；

3、国家开发投资集团有限公司直接持有国投资本股份有限公司 41.62% 的股份，并通过子公司中国国投国际贸易有限公司间接持有国投资本股份有限公司 3.65% 的股份；国投资本股份有限公司直接持有安信证券 99.9969% 的股份，并通过子公司上海毅胜投资有限公司间接持有安信证券 0.0031% 的股份。

(二) 保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况:

本保荐机构将安排保荐机构另类投资子公司安信证券投资有限公司参与本次发行战略配售, 具体跟投的股份数量和金额将按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定。

(三) 发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;

(四) 保荐机构的保荐代表人及其配偶, 董事、监事、高级管理人员, 不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份, 以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况;

(五) 保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况;

(六) 保荐机构与发行人之间不存在其他利害关系及业务往来情况。

五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项

(一) 本保荐机构承诺已按照法律法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定, 对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查, 充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题, 履行了相应的内部审核程序。

本保荐机构在充分了解发行人的经营状况及其面临的风险和问题后, 有充分理由相信发行人符合有关法律、法规及中国证监会规定的发行条件, 并确信发行人的申请文件真实、准确、完整, 同意作为保荐机构推荐其首次公开发行股票并在科创板上市。

(二) 本保荐机构就《证券发行上市保荐业务管理办法》第二十六条所列的相关事项作出如下承诺:

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定;

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9、中国证监会规定的其他事项。

（三）本保荐机构承诺，自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

（四）本保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。

六、发行人就本次证券发行上市履行的相关决策程序

发行人于 2021 年 3 月召开了第一届董事会第四次会议，于 2021 年 3 月召开了 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了本次发行的相关决议：《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》《关于公司首次公开发行股票募集资金使用方案及可行性的议案》《关于授权董事会全权办理公司首次公

开发股票并在科创板上市相关具体事宜的议案》《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》《关于<公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案>的议案》《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》《关于首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<无锡市好达电子股份有限公司章程（草案）>的议案》等议案。

根据发行人提供的董事会和股东大会会议通知、决议、会议记录等相关文件，本保荐机构核查后认为：上述会议的召集、召开、表决程序及决议内容符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，决议程序及内容合法、有效。

经核查，本保荐机构认为：发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》《科创板注册办法》等法律、法规、规范性文件规定的决策程序。

七、保荐机构关于发行人是否符合科创板定位的核查

根据发行人出具的《关于无锡市好达电子股份有限公司科创属性符合科创板定位要求的专项说明》并经保荐机构核查，好达电子属于《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》及《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》中要求的符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力突出、市场认可度高的科技创新企业，且属于科创板重点支持的新一代信息技术领域企业，符合科创板定位。

2021年4月16日，证监会发布针对科创板的《科创属性评价指引（试行）》。本保荐机构根据该评价体系的要求，逐项核查发行人相关指标，认为好达电子符合“研发投入金额”、“研发人员占比”、“发明专利”、“营业收入或营业收入复合增长率”四项指标，符合中国证监会制定的《科创属性评价指引（试行）》规定。

八、保荐机构对发行人是否符合科创板上市条件的核查

本保荐机构通过尽职调查，对照《科创板上市规则》的有关规定进行了逐

项核查，认为发行人本次发行符合《科创板上市规则》的相关规定。具体查证过程如下：

（一）针对《科创板上市规则》第 2.1.1 条的核查

1、发行人符合中国证监会规定的发行条件

本保荐机构通过尽职调查，对照《科创板注册办法》的有关规定进行了逐项核查，认为发行人本次发行符合《科创板注册办法》的相关规定。具体查证过程如下：

（1）针对《科创板注册办法》第十条的核查

保荐机构查阅了发行人设立、改制的工商登记资料，创立大会决议和议案，以及审计报告、评估报告、验资报告等材料。经核查，发行人前身无锡市好达电子有限公司系于 1999 年 6 月 14 日成立，于 2020 年 6 月 8 日按账面净资产值折股整体变更为股份有限公司。保荐机构经核查后认为：从有限公司成立之日起计算，发行人是依法设立的股份有限公司，且持续经营 3 年以上。

保荐机构核查了发行人股份公司设立以来的股东大会及董事会、监事会文件。经核查，发行人已建立并健全股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度及包括审计委员会在内的董事会专门委员会制度，形成了规范的公司治理结构。公司股东大会、董事会、监事会按照相关法律、法规、规范性文件、公司章程及相关议事规则的规定规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按相关制度规定切实地行使权利、履行义务。发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

因此，发行人符合《科创板注册办法》第十条的规定。

（2）针对《科创板注册办法》第十一条的核查

本保荐机构查阅了公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏公 W[2021]A996 号）、《内部控制鉴证报告》（苏公 W[2021]E1310 号）。经核查，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关

会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映发行人的财务状况、经营成果与现金流量；发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性。

因此，发行人符合《科创板注册办法》第十一条的规定。

（3）针对《科创板注册办法》第十二条的核查

保荐机构核查了发行人商标、专利、软件著作权等主要资产的权属资料，主要业务流程图、组织机构设置的有关文件，财务会计制度、银行开户资料、纳税资料、审计报告，公司章程等内部规章制度、三会相关决议，报告期内发行人主要的关联方和关联交易情况、发行人控股股东和实际控制人及其控制的其他企业的基本情况，并实地考察了发行人日常办公场所及生产经营场所，实地走访了主要业务部门。保荐机构经核查后认为：发行人的资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显示公平的关联交易。

保荐机构核查了发行人报告期内的主营业务收入构成，发行人历次董事会会议和股东大会会议决议文件、历次工商变更材料，对发行人股东进行调查。经核查，发行人最近2年内主营业务和董事、高级管理人员和核心技术人员均没有发生重大不利变化，实际控制人没有发生变更；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近2年内实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能发生变更的权属纠纷。

保荐机构核查了发行人的商标、专利等主要资产及核心技术的权属情况，对高级管理人员和财务人员进行了访谈，通过公开信息查询验证。经核查，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，不存在重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，亦不存在经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

因此，发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，符合《科创板注册办法》第十二条的规定。

(4) 针对《科创板注册办法》第十三条的核查

保荐机构查阅了发行人、控股股东的营业执照、公司章程及所属行业相关法律法规，核查了发行人、控股股东的企业征信报告，实际控制人的个人信用报告及无犯罪证明，发行人的董事、监事和高级管理人员简历及上述人员的声明，并通过公开信息查询验证。

经核查，发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。最近3年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

经核查，发行人现任董事、监事、高级管理人员不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚，或者涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

因此，发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《科创板注册办法》第十三条的规定。

发行人符合中国证监会规定的发行条件。

2、发行人本次发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元

本次发行前，发行人股本总额为 7,625 万股。2021 年 3 月，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过本次公开发行股票不超过 2,541.67 万股，本次发行后股本总额不超过 10,166.67 万股。综上，本保荐机构认为，发行人本次发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元。

3、发行人本次发行后总股本不超过 4 亿元，本次公开发行股份的比例不低于发行后总股本的 25%

本次发行前，发行人股本总额为 7,625 万股。2021 年 3 月，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过本次公开发行股票不超过 2,541.67 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。综上，本保荐机构认为，发行人本次发行不

低于本次发行后总股本的 25%。

（二）针对《科创板上市规则》第 2.1.2 条的核查

发行人适用《科创板上市规则》第 2.1.2 条第（一）项上市标准之“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。”。

保荐机构核查了公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏公 W[2021]A996 号），发行人的工商登记资料，行业估值情况等。

发行人 2019 年、2020 年归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 2,549.36 万元、4,402.88 万元，超过人民币 5,000 万元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。结合公司的技术水平、盈利能力和市场估值水平合理估计，预计发行人上市后的市值不低于人民币 10 亿元。

因此，发行人符合《科创板上市规则》第 2.1.2 条第（一）项上市标准之“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元的上市标准”。

经核查，本保荐机构认为，发行人符合《科创板注册办法》、《科创板上市规则》规定的发行和上市条件。

九、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排

| 事项 | 工作安排 |
|-------------------------------------|--|
| （一）持续督导事项 | 在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后三个完整会计年度内对发行人进行持续督导。 |
| 1、督促上市公司建立和执行信息披露、规范运作、承诺履行、分红回报等制度 | 1、与发行人建立经常性沟通机制，强化发行人严格执行中国证监会、上海证券交易所有关规定的意识，督促上市公司及时履行信息披露义务； 2、协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律、法规及规范性文件的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员、核心技术人员知晓各项义务； |

| 事项 | 工作安排 |
|--|---|
| | <p>3、督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；</p> <p>4、对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性；</p> <p>5、督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息；</p> <p>6、督促上市公司或其控股股东、实际控制人对其承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。并持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。对上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、《科创板上市规则》以及上海证券交易所其他规定的，及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正；</p> <p>7、督促控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况；</p> <p>8、关注上市公司使用募集资金的情况，督促其合理使用募集资金并持续披露使用情况；</p> <p>9、督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。</p> |
| <p>2、识别并督促上市公司披露对公司持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事项，并发表意见</p> | <p>1、持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东大会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项；</p> <p>2、核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。披露内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，应当发表意见予以说明；</p> <p>3、持续关注对上市公司日常经营、核心竞争力、控制权稳定性有重大不利影响的风险和相关事项，督促公司严格履行信息披露义务，并于公司披露公告时，就信息披露是否真实、准确、完整等发表意见并披露。无法按时履行上述职责的，应当披露尚待核实的事项及预计发表意见的时间，并充分提示风险。</p> |
| <p>3、关注上市公司股票交易异常波动情况，督促上市公司按照《科创板上市规则》规定履行核查、信息披露等义务</p> | <p>上市公司股票交易出现严重异常波动的，督促上市公司及时履行信息披露义务。</p> |
| <p>4、对上市公司存在的可能严重影响公司或者投资者合法权益的事项开展专项核查，并出具现场核查报告</p> | <p>在上市公司出现可能严重影响公司或者投资者合法权益的特定情形时进行专项现场检查，就核查情况、提请上市公司及投资者关注的问题、本次现场核查结论等事项出具现场核查报告并及时披露。</p> |
| <p>5、定期出具并披露持续督导跟踪报告</p> | <p>定期或者不定期对发行人进行回访，查阅所需的相关材料并按照规定定期出具持续督导跟踪报告。</p> |
| <p>6、中国证监会、上海证券交易所规定或者保荐协议约定的其他职责。</p> | <p>按照中国证监会、上海证券交易所规定或者保荐协议履行的其他职责。</p> |

| 事项 | 工作安排 |
|---------------------------------|--|
| (二) 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定 | <p>发行人及其高管人员以及为发行人本次发行与上市提供专业服务的各中介机构及其签名人员将全力支持、配合保荐机构履行保荐工作,为保荐机构的保荐工作提供必要的条件和便利,亦依照法律及其它监管规则的规定,承担相应的责任。</p> <p>主要工作包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、根据保荐机构和保荐代表人的要求,及时提供履行持续督导职责必需的相关信息; 2、发生应当披露的重大事项或者出现重大风险的,及时告知保荐机构和保荐代表人; 3、发行人应根据保荐机构和保荐代表人的督导意见,及时履行信息披露义务或者采取相应整改措施; 4、协助保荐机构和保荐代表人披露持续督导意见; 5、为保荐机构和保荐代表人履行持续督导职责提供其他必要的条件和便利; 6、其他必要的支持、配合工作。 |
| (三) 其他安排 | 无 |

十、保荐机构对本次股票上市的推荐结论

保荐机构安信证券股份有限公司认为:无锡市好达电子股份有限公司符合《公司法》、《证券法》及《科创板上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,其股票具备在上海证券交易所科创板上市的条件。安信证券股份有限公司同意担任无锡市好达电子股份有限公司本次发行上市的保荐机构,推荐其股票在上海证券交易所科创板上市交易,并承担相关保荐责任。

请予批准。

(以下无正文)

(本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于无锡市好达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签章页)

项目协办人(签名): 陈磊
陈磊

保荐代表人(签名): 周鹏翔 王庆坡
周鹏翔 王庆坡

内核负责人(签名): 廖笑非
廖笑非

保荐业务负责人(签名): 秦冲
秦冲

保荐机构总经理(签名): 王连志
王连志

保荐机构法定代表人、
董事长(签名): 黄炎勋
黄炎勋



2021年6月28日